

Rec'd PCT Int'l 10 MAR 2005

PCT/EP 02/03120

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

10/527 258



REC'D 14 MAY 2002  
WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

Aktenzeichen: 101 13 599.8

Anmeldetag: 20. März 2001

Anmelder/Inhaber: Fisba Optik AG,  
St. Gallen/CH

Bezeichnung: Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen  
von optischen Elementen

IPC: B 24 C, B 24 B

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 11. April 2002  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Eberl

# Dr. Münich & Kollegen

## Anwaltskanzlei

Dr. Münich & Kollegen, Anwaltskanzlei  
Wilhelm-Mayr-Str. 11, D-80689 München

Telefon: (+49) (0)89 / 54 67 00-0  
Telefax: (+49) (0)89 / 54 67 00-49, -99

An das  
Deutsche Patent- und  
Markenamt  
  
80297 München

**Patentanwälte /**  
**European Patent & Trademark Attorneys**  
Dr. rer. nat. Wilhelm-L. Münich, Dipl.-Phys.  
Dr.-Ing. Georg Lohr, Dipl.-Ing.

**Rechtsanwälte**  
Dr. jur. Walter O. Schiller †

20.03.2001

**Unser Zeichen:** Fi 2001/01

### Neue deutsche Patentanmeldung

**Anmelder:** Fisba Optik AG  
Schweiz

**Bezeichnung:** Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von  
Flächen von optischen Elementen

**BESCHREIBUNG****5 Technisches Gebiet**

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen von Elementen und insbesondere von optischen Elementen bzw. Werkstücken.

**10 Stand der Technik**

Zur abrasiven Bearbeitung von Flächen, wie sie beispielsweise für die Herstellung von optischen Elementen, wie Linsen, Prismen, planparallelen Platten etc., aber auch von Formen für das Gießen oder das Pressen optischer Elemente erforderlich ist, sind die verschiedensten Verfahren und Vorrichtungen bekannt. Bei vielen der bekannten Verfahren bzw. Vorrichtungen wird die zu bearbeitende Fläche mit kontaktierenden Werkzeugen, wie z.B. Teller-Schleifern, Kugelschleifern etc. zunächst einem Schleifvorgang sowie ggf. einem Feinschleifvorgang und anschließend mit einem Polierwerkzeug einem Polievorgang unterzogen. An Stelle von Schleifvorgängen ist es auch bekannt, die Flächen auf einer Drehbank mit einem geeigneten Drehmeißel einem Drehvorgang zu unterziehen oder ein anderes spanabhebendes Verfahren anzuwenden. Die meisten Bearbeitungsvorgänge, bei denen vergleichsweise viel Material abgetragen wird, erfordern zumindest dann, wenn optische Flächen hergestellt werden sollen, abschließend ein Polieren der Fläche. Das Polieren erfolgt nach dem 30 Stand der Technik bei sphärischen Flächen großflächig mit einem Polierteller.

Probleme ergeben sich bei den herkömmlichen Verfahren und Vorrichtungen immer dann, wenn asphärische Flächen hergestellt werden sollen. Die Herstellung asphärischer Flächen erfolgt nach dem Stand der Technik mit Werkzeugen wie Kugelschleifern, die einen mehr oder weniger punktförmigen Eingriff mit der zu bearbeitenden Fläche haben und die längs einer Bahn über die zu bearbeitende Fläche geführt werden. Je nach Ausbildung des Werkzeugs wird die Fläche dabei geschliffen oder poliert. Aus Zeit- bzw. Kostengründen werden allerdings asphärische Flächen häufig nur bahnförmig geschliffen; das Polieren erfolgt dann nicht bahnförmig, sondern großflächig. Insbesondere dann, wenn die Asphärität vergleichsweise groß ist, wie dies beispielsweise bei progressiven Brillengläsern der Fall ist, ergibt sich durch das flächige Polieren ein mehr oder weniger großer Polierfehler, der durch entsprechende Fertigungsvorhalte bei den vorangehenden Bearbeitungsvorgängen kompensiert werden muss.

Weiterhin ist es bekannt, Flächen von Werkstücken und insbesondere von optischen Elementen mit Fluidstrahlen zu bearbeiten. Die hierfür vorgeschlagenen Vorrichtungen sind jedoch vergleichsweise aufwendig und erlauben auf Grund der mehr oder weniger punktförmigen Bearbeitung der Fläche dennoch keine schnelle Herstellung der Flächen.

**Darstellung der Erfindung**

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen und insbesondere zum Schleifen und/oder Polieren von Flächen von optischen Elementen anzugeben, die eine schnelle Bearbeitung der Flächen unabhängig von der Form der jeweils bearbeiteten Fläche erlaubt.

10 Eine erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe ist im Patentanspruch 1 angegeben. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Ansprüche 2 bis 10. In den Ansprüchen 11 bis 14 sind mögliche Verwendungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung beansprucht.

15 Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen und insbesondere zum Schleifen und/oder Polieren von optischen Elementen ein Werkzeug auf, das einen Fluid-Einlass und einen Fluid-Auslass hat. Eine Zuführeinheit fördert zu dem Fluid-Einlass eine Flüssigkeit, 20 in der abrasive Mittel gelöst sind. Diese Flüssigkeit strömt durch das Werkzeug zu einem Auslass, durch den sie aus dem Werkzeug austritt. Erfindungsgemäß wird dieses Werkzeug durch eine Positioniereinrichtung derart relativ zu der zu bearbeitenden Fläche positioniert, dass der Auslass, aus dem die Flüssigkeit austritt, der zu bearbeitenden Fläche insbesondere mit einem geringen Abstand gegenüber liegt. Dabei ist entscheidend, dass die Fläche des durch die Begrenzungswände des Auslasses und durch die zu bearbeitende Fläche gebildeten Ringspaltes 25 kleiner als die Querschnittsfläche des Einlasses ist.

Hierdurch tritt die Flüssigkeit, in der abrasive Mittel gelöst sind, mit einem wesentlich höheren Druck als dem Druck, mit dem sie in den Einlass einströmt, durch den Ringspalt radial zum Werkzeug aus. Durch die radial ausströmende Flüssigkeit erfolgt die Bearbeitung der Fläche des Werkstücks. Je nach der Art der in der Flüssigkeit gelösten abrasiven Mittel wird die Fläche im Bereich des Ringspaltes und damit linienförmig schleifend oder polierend bearbeitet. Durch die linienförmige Bearbeitung wird die Bearbeitungszeit im Vergleich zu den bekannten Verfahren bzw. Vorrichtungen, bei denen ein im wesentlichen punktförmiger Eingriff zwischen Werkzeug und Werkstück besteht, um Größenordnungen verkürzt.

Das Verhältnis des Drucks, mit dem die Flüssigkeit in das Werkzeug einströmt, zu dem Druck, mit dem die Flüssigkeit aus dem Ringspalt austritt, ist dabei umgekehrt proportional zum Verhältnis der Querschnittsfläche des Einlasses zur Querschnittsfläche des gebildeten Ringspaltes. Dies bedeutet, dass der "Bearbeitungsdruck" durch die Positionierung des Werkzeugs relativ zum Werkstück – anders ausgedrückt durch die Einstellung der Höhe des Ringspaltes – eingestellt werden kann, ohne dass der Druck, mit dem die Zuführeinheit die Flüssigkeit fördert, geändert werden müsste.

Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist dabei, dass einlassseitig mit vergleichsweise niedrigen Drücken gearbeitet werden kann: insbesondere kann die Zuführeinheit die Flüssigkeit mit einem Druck kleiner 20 bar, bevorzugt

kleiner 5 bar, ggf. sogar nur mit Atmosphärendruck för-  
dern. Für eine für den Bearbeitungsvorgang und die Bear-  
beitungsgeschwindigkeit vorteilhafte Druckerhöhung ist es  
bevorzugt, wenn die Querschnittsfläche des Einlasses we-  
5 nigstens um den Faktor fünf größer als die Querschnitts-  
fläche des gebildeten Ringspaltes ist. Dabei ist es wei-  
terhin bevorzugt, wenn die Höhe des gebildeten Ringspal-  
tes kleiner als 3 mm ist und insbesondere etwa 1 mm be-  
trägt.

10 In jedem Falle ist es von Vorteil, wenn die Positionier-  
einrichtung eine Steuereinheit aufweist, die die Positio-  
nierung des Werkzeuges entsprechend den Flächendaten der  
herzustellenden Fläche steuert. Bevorzugt ist es, wenn  
15 die Positionierung des Werkzeugen dabei so erfolgt, dass  
die Höhe des Ringspaltes während der Verschiebung längs  
der jeweiligen Bahnen konstant bleibt.

20 Die Positioniereinrichtung kann das Werkzeug prinzipiell  
längs beliebiger Bahnen relativ zum Werkstück, d. h. zu  
der zu bearbeitenden Fläche verschieben. Beispielsweise  
kann die Bahn eine mäanderförmige Bahn sein, wobei entwe-  
der das Werkzeug oder das Werkstück oder beide bewegt  
werden.

25 Ferner kann eine gleichzeitige Verschiebung des Werkzeugs  
und des Elements, von dem eine Fläche bearbeitet werden  
soll, erfolgen. Im Falle rotationssymmetrischer Flächen  
oder nur geringfügig von der Rotationssymmetrie abwei-  
30 chender Flächen ist es bevorzugt, wenn das Werkzeug längs

Bahnen bewegt wird, die durch den Flächenscheitel verlaufen und gleichzeitig das Werkstück bzw. das zu bearbeitende Element von einer Dreheinheit um eine Achse gedreht wird, die insbesondere die Rotationsachse der herzustellenden Fläche ist.

Um eine homogene Bearbeitung der Fläche längs des Ringspaltes zu erreichen, ist es ferner bevorzugt, wenn der Auslass einen kreisförmigen Querschnitt hat, und das Werkzeug zumindest im Bereich des Auslasses eine (kreis)-zylindrische Außenkontur aufweist.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird dadurch, dass die Querschnittsfläche des Einlasses kleiner als die des Auslasses ist, erreicht, dass eine Bearbeitung der Fläche nur linienförmig (bzw. kreisringförmig) im Bereich des Ringspaltes und nicht auch im Zentrum des Auslasses erfolgt.

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Größe des Werkzeugs der Form der zu bearbeitenden Fläche angepasst ist:

Zur Bearbeitung von planen Flächen kann der Außendurchmesser des Werkzeugs im Bereich des Auslasses in der Größenordnung der halben Apertur des optischen Elements liegen, so dass eine sehr schnelle Bearbeitung der Fläche bei größtmöglicher Homogenität des Bearbeitungsvorganges erreicht wird. Bei der Bearbeitung von gekrümmten Flächen liegt bevorzugt der Außendurchmesser des Werkzeugs in der Größenordnung des kleinsten Radius (kleinster Hauptkrüm-

mungsradius) der Fläche; hierdurch wird sichergestellt, dass die Höhe des Ringspaltes über den gesamten gebildeten Ringspalt praktisch konstant ist.

5 Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann zum Bearbeiten beliebiger Flächen von Elementen bzw. Werkstücken eingesetzt werden, die aus prinzipiell beliebigen Materialien bestehen können. Beispielsweise kann die erfindungsgemäße Vorrichtung aufgrund der hohen Bearbeitungsgeschwindigkeit zur Bearbeitung von Turbinenschaufeln aus Stahl eingesetzt werden.  
10

Besonders bevorzugt ist jedoch die Verwendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Schleifen und/oder Polieren optischer Flächen. Die jeweiligen Elemente können dabei im Falle von Linsen, Prismen, planparallelen Platten etc. - d.h. direkt hergestellter optischer Elemente - aus Quarz, einem optischen Glas oder einem Kunststoffmaterial bestehen; sollen Formen für das Gießen und/oder Pressen 15 etc. von optischen Elementen hergestellt werden, können die Elemente auch aus einem Metall, wie Stahl, oder einem keramischen Material bestehen.  
20

Da die Art des Abtrags im wesentlichen nicht von der Ausbildung des Werkzeugs, sondern von der Art der eingesetzten Flüssigkeit bzw. des (der) in der Flüssigkeit gelösten abrasiven Mittels (Mittel) abhängt, kann ein- und dieselbe Vorrichtung nacheinander zum Schleifen, gegebenenfalls Feinschleifen und abschließend zum Polieren eines Elements bzw. Werkstücks in ein- und derselben Auf- 25 30

spannung eingesetzt werden. Der Wechsel zwischen den einzelnen Bearbeitungsarten bedingt dann lediglich einen Austausch bzw. Wechsel des jeweils verwendeten Bearbeitungsfluids.

5

In jedem Falle ist es jedoch besonders bevorzugt, wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Bearbeitung von asphärischen Flächen eingesetzt wird.

10

#### **Kurze Beschreibung der Zeichnung**

Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung exemplarisch beschrieben, auf die im übrigen hinsichtlich der Offenbarung aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich verwiesen wird. Es zeigen:

20

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung bei der Bearbeitung einer planen Fläche,

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung bei der Bearbeitung einer gekrümmten und insbesondere asphärischen Fläche.

25

#### **Darstellung von Ausführungsbeispielen**

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung, von der lediglich das Werkzeug 1 dargestellt ist, bei der Bearbeitung einer planen Fläche 21 eines Werkstücks 2, das 30 ohne Beschränkung der Allgemeinheit eine planparallele

Platte ist. Das Werkzeug 1 weist einen Einlass 11 und einen Auslass 12 auf, dessen Querschnittsfläche größer ist als die des Einlasses 11. Eine nicht dargestellte Zuführ-  
einheit fördert eine Flüssigkeit, in der abrasive Mittel,  
5 wie Schleifmittel oder Poliermittel gelöst sind, in den Einlass 11 des Werkzeugs 1. Das Werkzeug 1 wird von einer nicht dargestellten Positioniereinheit derart relativ zum Werkstück 2 positioniert, dass zwischen den Begrenzungswänden 13 des Auslasses 12 und der Fläche 21 ein Ring-  
spalt 3 gebildet wird, dessen Querschnittsfläche kleiner  
10 und bevorzugt wesentlich kleiner als die Querschnittsfläche des Einlasses 11 ist. Hierdurch wird der Druck, mit dem die Flüssigkeit aus dem Ringspalt 3 austritt, um das Verhältnis der Querschnittsflächen des Einlasses 11 und des Ringspaltes 3 erhöht. Der für die Bearbeitung der Werkstück-Oberfläche 21 wirksame Druck ist damit wesent-  
15 lich größer als der Förderdruck.

Die nicht dargestellte Positioniereinrichtung verschiebt  
20 das Werkzeug 1 parallel zur Oberfläche des Werkstücks 2, während eine ebenfalls nicht dargestellte Dreheinheit das Werkstück 2 um eine Achse 22 dreht, so dass der linienförmige Eingriff längs des Ringspaltes 3 so über das Werkstück 2 verschoben wird, dass die gesamte Fläche 21  
25 gleichmäßig bearbeitet, beispielsweise poliert wird.

Der Durchmesser des Werkzeugs 1 liegt in der Größenordnung des Radius des Werkstücks 2.

Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung bei der Bearbeitung einer gekrümmten und insbesondere asphärischen Fläche 21' eines Werkstücks 2. Gleiche Teile sind dabei mit den selben Bezugszeichen versehen, so dass auf 5 eine erneute Vorstellung verzichtet wird. Der Durchmesser des Werkzeugs 1 liegt in der Größenordnung des kleinsten Radius der asphärischen Fläche 21'. Die ebenfalls nicht dargestellte Positioniereinheit verschiebt das Werkzeug 1 längs Bahnen, die durch den Scheitel der Fläche 21' verlaufen. Gleichzeitig wird das Werkstück 2 um eine durch den Scheitel verlaufende Rotationsachse 22 gedreht.

10 Vorstehend ist die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsdankens beschrieben worden.

PATENTANSPRÜCHE

- 5    1. Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen  
von Elementen mit  
- einem Werkzeug, das einen Einlass und einen  
Auslass aufweist,  
- einer Zuführeinheit, die zu dem Einlass eine  
Flüssigkeit fördert, in der abrasive Mittel ge-  
löst sind, und die aus dem Auslass austritt,  
und  
- einer Positioniereinrichtung, die das Werkzeug  
über die zu bearbeitende Fläche führt und dabei  
derart positioniert, dass der Auslass der zu  
bearbeitenden Fläche gegenüber liegt, wobei die  
Fläche des durch die Begrenzungswände des Aus-  
lasses und die zu bearbeitende Fläche gebil-  
deten Ringspaltes kleiner als die Querschnitts-  
fläche des Einlasses ist.
- 10  
15  
20
2. Vorrichtung nach Anspruch 1,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass die Querschnittsfläche  
des Einlasses wenigstens um den Faktor fünf größer  
als die Querschnittsfläche des gebildeten Ringspal-  
tes ist.
- 25
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass die Höhe des gebildeten

Ringspaltes kleiner als 3 mm ist und bevorzugt etwa 1 mm beträgt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass eine Dreheinheit vorgesehen ist, die das zu bearbeitende Element um eine Achse dreht.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass der Auslass einen kreisförmigen Querschnitt hat, und dass das Werkzeug zumindest im Bereich des Auslasses eine zylindrische Außenkontur aufweist.
- 10 15 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass die Querschnittsfläche des Einlasses kleiner als die des Auslasses ist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass die Zuführeinheit die Flüssigkeit mit einem Druck kleiner 20 bar, bevorzugt kleiner 5 bar fördert.
- 20 25 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass zur Bearbeitung von planen Flächen der Außendurchmesser des Werkzeugs im Bereich des Auslasses in der Größenordnung der halben Apertur des optischen Elements liegt.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass bei der Bearbeitung von  
gekrümmten Flächen der Außendurchmesser des Werk-  
zeugs in der Größenordnung des kleinsten Radius der  
5 Fläche liegt.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,  
dadurch **gekennzeichnet**, dass die Positioniereinrich-  
tung eine Steuereinheit aufweist, die die Positio-  
nierung des Werkzeuges entsprechend den Flächendaten  
der herzustellenden Fläche steuert.  
10
11. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprü-  
che 1 bis 10 zum Schleifen optischer Flächen.  
15
12. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprü-  
che 1 bis 10 zum Polieren optischer Flächen.
13. Verwendung einer einzigen Vorrichtung nach einem der  
Ansprüche 1 bis 10 zunächst zum Schleifen und an-  
schließend zum Polieren einer optischen Fläche.  
20
14. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprü-  
che 1 bis 10 zur Bearbeitung von asphärischen Flä-  
chen.  
25

ZUSAMMENFASSUNG

- 5 Beschrieben wird eine Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen von Elementen mit
- einem Werkzeug, das einen Einlass und einen Auslass aufweist,
  - einer Zuführeinheit, die zu dem Einlass eine Flüssigkeit fördert, in der abrasive Mittel gelöst sind, und die aus dem Auslass austritt, und
  - einer Positioniereinrichtung, die das Werkzeug über die zu bearbeitende Fläche führt und dabei derart positioniert, dass der Auslass der zu bearbeitenden Fläche gegenüber liegt, wobei die Fläche des durch die Begrenzungswände des Auslasses und die zu bearbeitende Fläche gebildeten Ringspaltes kleiner als die Querschnittsfläche des Einlasses ist.

10

15

20

BEST AVAILABLE COPY

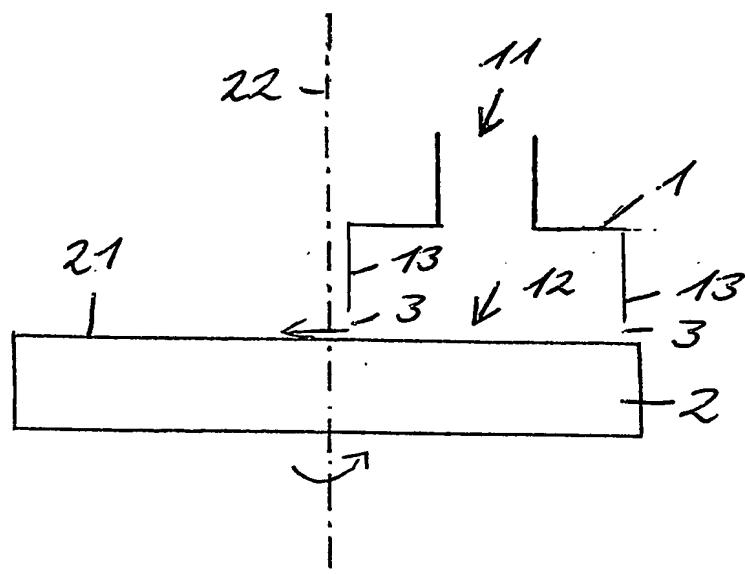


Fig. 1

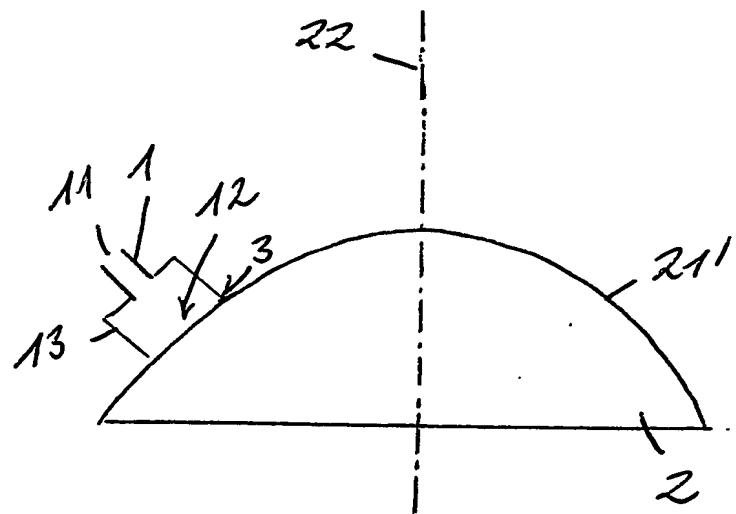


Fig. 2